

## Pt 插层对铁磁/反铁磁界面交换耦合的影响\*

王一军 刘洋 于广华†

(北京科技大学材料物理与化学系, 北京 100083)

(2011年12月13日收到; 2012年1月7日收到修改稿)

在铁磁层 (FM)/反铁磁层 (FeMn) 耦合体系中插入 Pt 插层或对靠近 FM/FeMn 界面处的 FeMn 掺杂 Pt 元素, 研究了体系的交换偏置场  $H_{\text{ex}}$  及矫顽力  $H_c$  随 Pt 插层深度  $d_{\text{Pt}}$  与 Pt 掺杂层厚度  $t_{\text{Pt/FeMn}}$  的变化关系. 实验结果表明, 引入 Pt 插层后 NiFe/FeMn( $d_{\text{Pt}}$ )/Pt/FeMn 体系的未补偿磁矩 (UCS) 的数量得到很大的提高, 从而对  $H_{\text{ex}}$  与  $H_c$  起到增强的作用; 同时, 从实验结果可以推测 FeMn 层内部 UCS 的分布深度约为 1.3 nm. 另外, 对靠近 FM/FeMn 界面处的 FeMn 掺杂 Pt 元素, 发现掺入 Pt 元素后体系的  $H_{\text{ex}}$  得到有效增强, 这是因为掺入 Pt 元素后体系 UCS 的数量也得到很大的提高.

**关键词:** 磁性多层膜, 交换耦合, Pt 插层, 未补偿磁矩

**PACS:** 75.70.Ak, 75.70.-i, 81.15.Cd

## 1 引言

由于自旋阀、自旋电子器件及信息存储器的广泛应用<sup>[1-3]</sup>, 铁磁层 (FM) 与反铁磁层 (AFM) 之间的界面交换耦合作用一直以来为人们所广泛关注, 这种交换耦合作用称作交换偏置 (EB) 现象, 即铁磁层的磁滞回线中心沿磁场方向偏离原点, 偏离的大小为交换偏置场  $H_{\text{ex}}$ , 并伴随矫顽力  $H_c$  的增大<sup>[4]</sup>. 尽管交换偏置现象发现已经半个多世纪, 近二十年来对它的研究取得很大的突破并提出了几种模型<sup>[4-9]</sup>, 但由于  $H_{\text{ex}}$  受各种因素的影响十分复杂, 目前还没有形成一个理论模型能统一地解释所有的交换偏置现象. 不过, 现在已有关于交换偏置的报道都表明<sup>[10,11]</sup>, 交换偏置与 AFM 界面的磁矩排列密切相关.

Takano 等<sup>[11]</sup> 首次利用超导量子干涉仪 (SQUID) 证明了 AFM 未补偿磁矩 (UCS) 与交换偏置的密切联系. 随后, 由于实验测试手段的进步, 如: SQUID<sup>[11-13]</sup>、X 射线磁圆二色/X 射线磁线二色 (XMCD/XMLD)<sup>[14,15]</sup>、磁光克尔效应 (MOKE effect)<sup>[16]</sup>、X 射线磁共振散射仪 (XRMR)<sup>[17]</sup>、极

化中子散射仪 (PNR)<sup>[13]</sup> 等, 人们已经能够直接观察到界面处 UCS 的数量、方向和分布, 甚至可以观察到界面处磁畴结构, 这都为研究交换偏置提供了十分可靠的实验数据. 通过研究表明 FM/AFM 界面的未补偿磁矩可以分为两个部分<sup>[12-16]</sup>: 一部分在外场作用下随着 FM 层的翻转而翻转, 这部分 UCS 会引起  $H_c$  的增加; 另一部分 UCS 处于钉扎状态, 从而导致 EB 的产生. 早期, 人们以为只有 FM/AFM 界面一两个原子层内存在 UCS<sup>[15]</sup>, 但最近的文献报道, 不仅在 FM/AFM 界面处存在 UCS, 在 AFM 层内部且靠近界面一定深度处也存在 UCS<sup>[17]</sup>. 近十年来, 人们开始通过在 FM/AFM 双层膜界面处插入非磁性 (NM) 插层或掺杂 AFM 来研究 EB 的机理<sup>[18-23]</sup>, 发现在界面处引入插层或掺杂 AFM 都能改变 AFM 层界面磁矩的数量与状态, 从而调节 FM/AFM 双层膜的  $H_{\text{ex}}$  和  $H_c$ . 例如: 在 NiFe/FeMn, Co/FeMn 和 (Pt/Co)<sub>4</sub>/FeMn 等 FM/AFM 界面插入超薄 Pt 层, 将会产生额外的 UCS, 从而增强了 FM/AFM 体系的  $H_{\text{ex}}$  和  $H_c$ <sup>[24]</sup>. 但不同体系中 UCS 的数量、钉扎比例 (钉扎状态的 UCS 占体系全部 UCS 的百分比) 和分布深度究竟受哪些因素影响并不是十分

\* 国家自然科学基金 (批准号: 51071023, 50831002) 资助的课题.

† E-mail: ghyu@mater.ustb.edu.cn

清楚, 仍需进一步研究. 本文通过在 AFM 层内部引入 Pt 插层及对靠近界面处的 AFM 掺杂 Pt 元素的方法, 改变 Pt 插层厚度、深度及 Pt 掺杂层厚度来调节 AFM 层磁矩状态, 讨论其对 FM/AFM 双层膜磁滞回线、交换偏置场和矫顽力的影响, 进而从体系中 UCS 的数量、钉扎比例和分布深度来揭示 FM/AFM 体系中的交换耦合作用与界面 UCS 之间的相互关系.

## 2 实验

本实验样品均在 DV-502 型磁控溅射仪系统中制备, 溅射前的本底真空优于  $4 \times 10^{-5}$  Pa, 薄膜的生长在 0.5 Pa 的 99.99% 高纯 Ar 气氛下进行, 所有样品均生长在玻璃基片上. 实验中所用的 Ni<sub>81</sub>Fe<sub>19</sub> 靶、Fe<sub>50</sub>Mn<sub>50</sub> 靶、Co 靶的纯度均为 99.9%, Pt 靶纯度为 99.95%, 其中 NiFe 靶、Co 靶、FeMn 靶采用直流溅射, Pt 靶采用射频溅射, 其溅射速率分别为 0.055, 0.084, 0.055 和 0.050 nm/s (各种靶的溅射速率均由台阶仪测定). 制备样品时在平行膜面方向加一个诱导场, 感生一个易磁化方向, 诱导场大小约为 63.7 kA/m. 样品被切成 3 mm × 5 mm 大小, 在室温下利用综合物性测量系统 (PPMS) 测量样品的磁滞回线, 测量磁场平行于膜面, 沿着易磁化方向, 最大场为 31.8 kA/m. 室温条件下, 在 22 mm × 22 mm 玻璃基片上沉积了 S1, S2, S3, S4 四组样品 (本文中薄膜厚度单位均为 nm), 其基本结构是:

- S1: Pt20.0/NiFe4.0/FeMn( $d_{Pt}$ )/Pt1.0/FeMn4.0/Pt8.0 ( $d_{Pt} = 0-9.0$  nm);
- S2: Pt20.0/NiFe4.0/FeMn1.5/Pt( $t_{Pt}$ )/FeMn9.5/Pt8.0 ( $t_{Pt} = 0-4.0$  nm);
- S3: Pt20.0/NiFe10.0/Pt<sub>40</sub>Fe<sub>30</sub>Mn<sub>30</sub>( $t_{PtFeMn}$ )/FeMn(25.0 -  $t_{PtFeMn}$ )/Pt8.0 ( $t_{PtFeMn} = 0-1.3$  nm);
- S4: Pt20.0/(Pt2.0/Co0.3)<sub>4</sub>/Pt<sub>40</sub>Fe<sub>30</sub>Mn<sub>30</sub>( $t_{PtFeMn}$ )/FeMn(25.0 -  $t_{PtFeMn}$ )/Pt8.0 ( $t_{PtFeMn} = 0-1.3$  nm).

为了方便, 这里我们将 S1 组中下面薄的 FeMn 层称为  $\delta$  层, 其厚度表示为  $d_{Pt}$ , 即 1.0 nm Pt 插层的深度. 其中, 所有样品制备前, 先在基片上面首先生长 20 nm 的 Pt 层作为缓冲层并诱导 NiFe 的 (111) 结构, 样品的最上面再生长 12 nm 的 Pt 层作为保护层. S3, S4 组中掺杂层 Pt<sub>40</sub>Fe<sub>30</sub>Mn<sub>30</sub> 由 Pt 靶与 FeMn 靶共溅射生长.

## 3 结果与讨论

图 1 为体系 S1 与体系 NiFe4.0/FeMn( $t_{FeMn}$ ) 的  $H_{ex}$  和  $H_c$  分别随  $d_{Pt}$  与  $t_{FeMn}$  变化的关系曲线. 从图 1(a) 可以看出, 体系 S1 在  $d_{Pt} = 0$  nm 时,  $H_{ex} = 480$  A/m; 随着  $d_{Pt}$  由 0 nm 增大到 0.6 nm,  $H_{ex}$  基本处于一稳定值; 当  $d_{Pt}$  继续增加,  $H_{ex}$  开始减少, 直到  $d_{Pt} = 1.3$  nm 时,  $H_{ex}$  下降为零; 当  $d_{Pt}$  增加到 2.0 nm 后, 即 NiFe4.0/FeMn ( $t_{FeMn}$ ) 体系产生交换耦合的临界厚度  $t_{C,FeMn}$  (如图 1(a) 插图所示) 时,  $H_{ex}$  开始增加, 并在  $d_{Pt} = 9$  nm 时达到饱和值约为 12736 A/m. 从图 1(b) 中可以观察到体系 S1

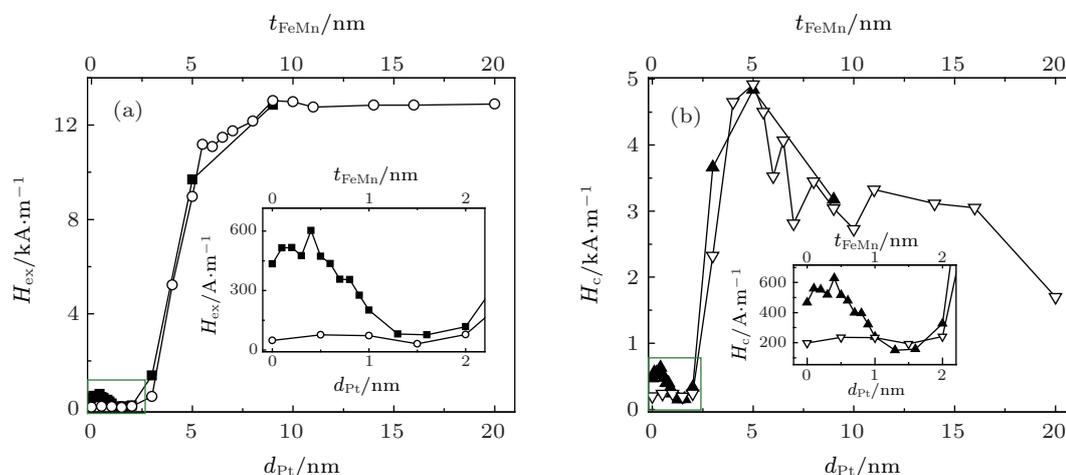


图 1 (a) 体系 S1 (实心方形) 与 NiFe4.0/FeMn( $t_{FeMn}$ ) (空心圆) 的  $H_{ex}$  分别随  $d_{Pt}$  与  $t_{FeMn}$  的变化关系, 插图表示体系 S1 的  $H_{ex}$  随插层深度  $d_{Pt}$  为 0—2.0 nm 时的变化关系; (b) 体系 S1 (实心上三角) 与 NiFe4.0/FeMn( $t_{FeMn}$ ) (空心下三角) 的  $H_c$  分别随  $d_{Pt}$  与  $t_{FeMn}$  的变化关系, 插图表示体系 S1 的  $H_c$  随插层深度  $d_{Pt}$  为 0—2.0 nm 时的变化关系

的  $H_c$  随  $d_{Pt}$  的变化规律与  $H_{ex}$  随  $d_{Pt}$  的变化规律基本一致.  $d_{Pt} = 0$  nm 时, 体系 S1 的  $H_{ex} = 480$  A/m, 说明在 NiFe4.0/FeMn4.0 界面处插入 1.0 nm 的 Pt 插层后, NiFe 与 FeMn 之间仍存在相当强的交换耦合作用, 即在 NiFe/FeMn 界面处引入 Pt 插层时, NiFe 与 FeMn 之间耦合作用为长程作用. 当  $d_{Pt} = 0-0.6$  nm 时, 体系 S1 的  $H_{ex}$  处于一稳定值约为 480 A/m, 说明在 FeMn 内部且靠近 NiFe4.0/FeMn4.0 界面处引入 1.0 nm Pt 插层, NiFe 与 FeMn 之间仍然存在交换耦合作用; 随着  $d_{Pt}$  继续增大,  $H_{ex}$  与  $H_c$  均开始减少, 这种交换耦合作用开始减弱, 在  $d_{Pt} = 1.3$  nm 时,  $H_{ex}$  减少为零, 这种交换耦合作用相应地减少为零. 这充分说明了当  $d_{Pt} = 0-0.6$  nm 时, 480 A/m 的  $H_{ex}$  并不是由  $\delta$  层所贡献, 而是由 4.0 nm FeMn 与 NiFe 层的耦合作用所产生. 当  $d_{Pt} > 2.0$  nm 时, 体系 S1 的  $H_{ex}$  又开始增大, 这是由于  $\delta$  层大于 2.0 nm 后, 已经能钉扎住 NiFe 层, 从而产生  $H_{ex}$ , 并在  $d_{Pt} = 9$  nm 时达饱和值约为 12736 A/m.

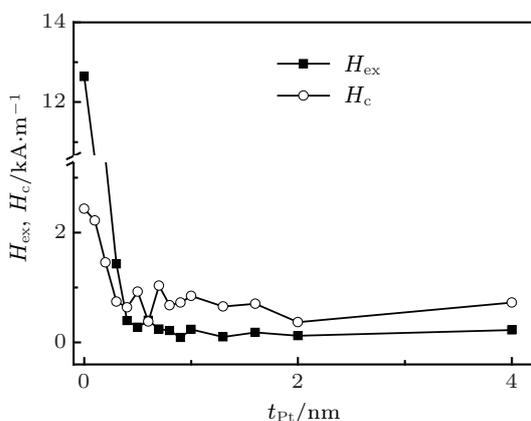


图 2 体系 S2 的  $H_{ex}$  和  $H_c$  随 Pt 插层厚度  $t_{Pt}$  的变化关系

图 2 表示体系 S2 的  $H_{ex}$  和  $H_c$  随 Pt 插层厚度  $t_{Pt}$  变化的关系. 从图 2 可观察到, 当 Pt 插层的厚度  $t_{Pt} = 0$  nm 时, 体系 S2 的  $H_{ex} = 12656$  A/m, 说明 11 nm 的 FeMn 能够很好地钉扎住 NiFe 层; 随着 Pt 插层厚度  $t_{Pt}$  的增大,  $H_{ex}$  呈指数趋势迅速衰减; 在  $t_{Pt} = 0.6$  nm 时, 体系 S2 的  $H_{ex}$  从 12656 A/m 衰减为零; 当  $t_{Pt} > 0.6$  nm 后,  $H_{ex}$  保持为零. 说明体系 S2 中整个 FeMn 层与 NiFe 之间的耦合作用随着 Pt 插层厚度  $t_{Pt}$  增加而迅速减弱. 这是因为随着  $t_{Pt}$  的增大, 1.5 nm 的 FeMn 与 9.5 nm 的 FeMn 的耦合作用逐渐减弱, 导致整个 FeMn 层的有效各向异性降低. 当  $t_{Pt} > 0.6$  nm 时, 9.5 nm 的 FeMn

层与 1.5 nm 的 FeMn 层组成的 AFM 层已经无法提供足够强的有效各向异性来钉扎住 4.0 nm 的 NiFe 层, 最终导致该体系的  $H_{ex}$  减少为零. 所以, 在体系 S1 中, 当  $d_{Pt} < 1.3$  nm 时, 体系 S1 的  $H_{ex}$  也不是由最上面 4.0 nm 的 FeMn 直接对 NiFe 层钉扎所贡献, 因为体系 S1 中 Pt 插层的厚度为 1.0 nm. 那么在  $d_{Pt} < 1.3$  nm 时, 体系 S1 的  $H_{ex}$  到底是如何产生的呢?

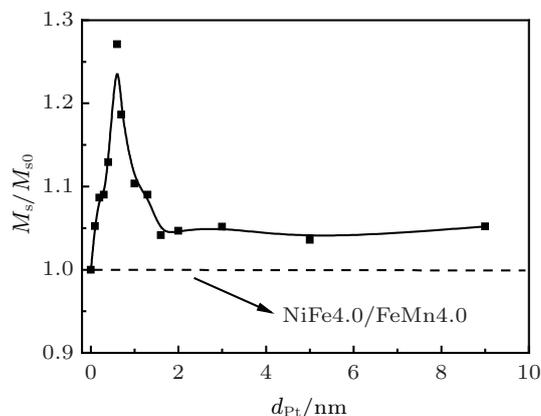


图 3  $M_s/M_{s0}$  随 Pt 插层深度  $d_{Pt}$  的变化关系 其中虚线为 NiFe4.0/FeMn4.0 双层膜饱和磁矩的数据

图 3 为体系 S1 的饱和磁矩  $M_s$  与 NiFe4.0/FeMn4.0 饱和磁矩  $M_{s0}$  的比值  $M_s/M_{s0}$  随 Pt 插层深度  $d_{Pt}$  变化的关系. 从图 3 中可以看到, 插入 Pt 插层后, 体系 S1 的  $M_s$  得到很大提高, 说明体系 S1 的净磁矩的数量得到大大提高. 体系 S1 的  $M_s$  随着  $d_{Pt}$  的增大先迅速增加, 在  $d_{Pt} = 0.6$  nm 时到达最大值,  $M_s$  提高了 25%; 当  $d_{Pt}$  继续增大, 体系 S1 的  $M_s$  开始减少, 在  $d_{Pt} = 1.3$  nm 时, 仅提高了 5%;  $d_{Pt} \geq 1.3$  nm 时, 体系 S1 的  $M_s$  保持一稳定值. 当  $d_{Pt} = 0-0.6$  nm 时, 体系 S1 的  $M_s$  随着  $d_{Pt}$  的增大迅速增加, 对应体系 S1 的  $H_{ex}$  处于一稳定值. 这是因为  $d_{Pt} = 0-0.6$  nm 时,  $\delta$  层完全处于磁无序的状态,  $\delta$  层与 4.0 nm 的 NiFe 层共同组成名义 FM 层, 故  $M_s$  随着  $d_{Pt}$  的增大迅速增加. 这样, 名义 FM 层与 4.0 nm 的 FeMn 层之间仅隔着 1.0 nm 的 Pt 层, 故名义 FM 层与 4.0 nm 的 FeMn 层之间交换耦合强度几乎不变, S1 体系的  $H_{ex}$  便会在  $d_{Pt} = 0-0.6$  nm 时处于一稳定值, 约为 480 A/m.  $d_{Pt} = 0.6-1.3$  nm 时, 体系 S1 的  $M_s$  开始减少, 这是由于  $\delta$  层大于 0.6 nm, 即  $d_{Pt} > 0.6$  nm 后,  $\delta$  层很可能已经由岛状结构生长成为连续的薄膜,  $\delta$  层的磁矩逐渐有序化, 开始由 FM 状态向 AFM 状态转变. 由于 1.0 nm 的 Pt 插层的引入, 增加了界面粗

糙度, 导致  $\delta$  层存在两个界面: NiFe/ $\delta$  层界面和  $\delta$  层/Pt 界面, 且两个界面可能都产生了额外的净磁矩, 这些额外的净磁矩正是体系 S1 中 UCS 的重要来源. 因此, 多层膜中界面粗糙度直接影响着 AFM 中 UCS 的数量与分布. 最上面 4.0 nm 的 FeMn 层经过 Pt 层与  $\delta$  层/Pt 界面的未补偿磁矩发生耦合作用, 从而对  $\delta$  层/Pt 界面的未补偿磁矩起到钉扎的效果, 进而钉扎住 NiFe/ $\delta$  层界面的未补偿磁矩, 最终 NiFe/ $\delta$  层界面的未补偿磁矩会对 NiFe 层钉扎.  $d_{\text{Pt}}$  在 0.6—1.3 nm 范围内增加时,  $\delta$  层磁矩有序化逐渐增加, 体系 S1 的  $M_s$  开始减少,  $\delta$  层/Pt 界面的未补偿磁矩便会逐渐减少, 相应地, 这种钉扎作用随着  $d_{\text{Pt}}$  的增加而减弱, 从而导致体系 S1 的  $H_{\text{ex}}$  在  $d_{\text{Pt}} = 0.6$ —1.3 nm 时逐渐减少. 体系 S1 中的  $H_{\text{ex}}$  在  $d_{\text{Pt}}$  增大到 1.3 nm 时减少为零, 这是由于  $\delta$  层/Pt 界面的未补偿磁矩减少为零, 最上层的 4 nm FeMn 不再对  $\delta$  层有钉扎作用, 故  $H_{\text{ex}}$  减少为零 (如图 1(a) 内插图所示), 故体系 S1 中 FeMn 层未补偿磁矩的分布深度约为 1.3 nm. 随着  $\delta$  层厚度进一步的增大, 当其厚度大于 FeMn 临界厚度  $t_{\text{c,FeMn}}$  时,  $\delta$  层薄层形成稳定有序的 AFM 相, 可以直接与 4 nm 的 NiFe 耦合并对其起钉扎作用, 因此  $H_{\text{ex}}$  开始增加.  $d_{\text{Pt}}$  在 0—1.3 nm 这个范围时, 体系 S1 的  $H_c$  大于 NiFe4.0/FeMn( $t_{\text{FeMn}}$ ) 的  $H_c$ , 这是因为在 FeMn 层内部插入 Pt 插层后, 可反转的 UCS 也增加了. 因此, Pt 插层的引入增加了 UCS 数量, 一部分 UCS 在外场作用下随着 FM 层的翻转而翻转, 会引起  $H_c$  的增加; 另一部分 UCS 处于钉扎状态, 从而导致 EB 的增强.

图 4 表示体系 S3, S4 的  $H_{\text{ex}}$  随着掺杂层厚度  $t_{\text{PtFeMn}}$  变化的关系. 如图 4 曲线 (a) 所示, 对体系 NiFe10.0/FeMn25.0 与 (Pt2.0/Co0.3)<sub>4</sub>/FeMn25.0 界面处的 FeMn 掺杂 Pt 元素, 当掺杂厚度  $t_{\text{PtFeMn}}$  为 0.4—1.0 nm 时, 体系 S3, S4 的  $H_{\text{ex}}$  得到有效增强. 体系 S3, S4 的  $H_{\text{ex}}$  随着掺杂厚度  $t_{\text{PtFeMn}}$  增大先减少, 在  $t_{\text{PtFeMn}} = 0.2$  nm 时出现极少值; 随着掺杂厚度继续增大, 体系 S3, S4 的  $H_{\text{ex}}$  都开始增强, 体系 S3 在  $t_{\text{PtFeMn}} = 0.85$  nm 时  $H_{\text{ex}}$  出现极大值, 从没有掺杂时的 15602 A/m 提高到 29770 A/m, 体系 S4 在  $t_{\text{PtFeMn}} = 0.50$  nm 时  $H_{\text{ex}}$  出现极大值, 其极大值为 8438 A/m. 这是因为, 粗糙的 PtFeMn 界面产生了大量的 UCS, 在 NiFe 层的拖拽下, 大部分额外的磁矩是可反转的. 与此同时, 当掺杂厚度合

适时, 由于与 NiFe 层隔开了一定的距离, 部分额外磁矩更多地受到 FeMn 层内部的钉扎作用, 这样界面钉扎态 UCS 的数量也增加了, 体系的  $H_{\text{ex}}$  和  $H_c$  可以同时增加. 而当掺杂层太薄 ( $t_{\text{PtFeMn}}$  约 0.2 nm) 时,  $H_{\text{ex}}$  并不提高, 与之相应的是体系的各向异性也相对较差. 这一方面是因为不完整插层会破坏界面处的表面各向异性, 另一方面因为未补偿磁矩离 FM 层太近会使其中绝大部分成为可反转磁矩, 钉扎态磁矩的数量和比例并不增加, 因此  $H_{\text{ex}}$  是下降的.

通过掺杂 FeMn 来制造未补偿自旋的办法最好只在 FeMn 靠近界面的几个原子层内实施, 如图 4 所示, 掺杂层 PtFeMn 的厚度在 0.4—1.0 nm 范围时  $H_{\text{ex}}$  出现极大值, 继续增加掺杂厚度, 体系的  $H_{\text{ex}}$  反而会破坏 FeMn 的 AFM 属性, 使  $H_{\text{ex}}$  大幅下降.

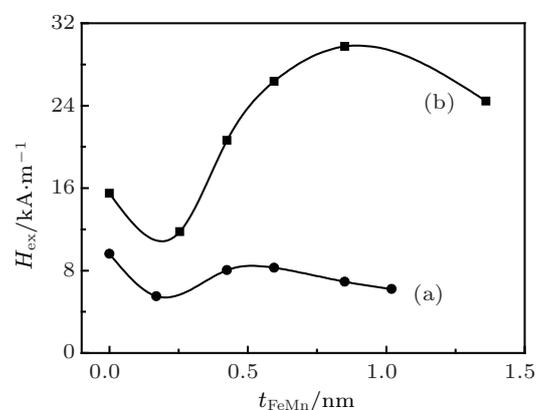


图 4 (a) 体系 S3 中的  $H_{\text{ex}}$  随掺杂层厚度  $t_{\text{PtFeMn}}$  的变化关系; (b) 体系 S4 中的  $H_{\text{ex}}$  随掺杂层厚度  $t_{\text{PtFeMn}}$  的变化关系

## 4 结论

对于 FM/FeMn 双层膜, 通过在 FeMn 层内部引入 Pt 插层和对靠近界面处的 FeMn 掺杂 Pt 元素的方法, 研究了 Pt 插层厚度与深度、Pt 掺杂层厚度对交换偏置体系  $H_{\text{ex}}$  和  $H_c$  的影响. 结果表明, 体系 NiFe/FeMn/Pt( $t_{\text{Pt}}$ )/FeMn 中的  $H_{\text{ex}}$  随 Pt 插层厚度增加呈指数趋势迅速衰减, 这是因为 Pt 插层的引入极大地降低了整个 FeMn 层的有效各向异性. 无论是在 FeMn 内部插入 Pt 插层还是对 FeMn 层靠近界面处掺杂 Pt 元素, 都能改变 FM/FeMn 体系中的 UCS 的数量, 从而调节 FM/FeMn 体系的  $H_{\text{ex}}$  与  $H_c$ , 因为引入 Pt 插层或对界面处 FeMn 掺杂 Pt

元素都能增加界面粗糙度, 为体系带来更多的 UCS. 实验结果也表明, 对于 NiFe/ FeMn 体系, UCS 不仅仅分布在界面处, 在 FeMn 内部一定深度

处也存在 UCS. 并且 AFM 层中 UCS 的分布深度与 FM 层材料、AFM 层材料及界面粗糙度等密切相关.

- [1] Dieny B 1994 *J. Magn. Magn. Mater.* **136** 335
- [2] Parkin S S P, Jiang X, Kaiser C, Panchula A, Roche K, Samant M 2003 *Proc. IEEE* **91** 661
- [3] Park B G, Wunderlich J, Martí X, Holý V, Kurosaki Y, Yamada M, Yamamoto H, Nishide A, Hayakawa J, Takahashi H, Shick A B, Jungwirth T 2011 *Nature Mater.* **10** 347
- [4] Meiklejohn W H, Bean C P 1956 *Phys. Rev.* **102** 1413
- [5] Mauri D, Siegmann H C, Bagus P S, Kay E 1987 *J. Appl. Phys.* **62** 3047
- [6] Malozemff A P 1987 *Phys. Rev. B* **35** 3679
- [7] Koon N C 1997 *Phys. Rev. Lett.* **78** 4865
- [8] Nowak U, Usadel K D, Keller J, Miltényi P, Beschoten B, Güntherodt G 2002 *Phys. Rev. B* **66** 014430
- [9] Keller J, Miltényi P, Beschoten B, Güntherodt G, Nowak U, Usadel K D 2002 *Phys. Rev. B* **66** 014431
- [10] Nogués J, Schuller I K 1999 *J. Magn. Magn. Mater.* **192** 203
- [11] Takano K, Kodama R H, Berkowitz A E, Cao W, Thomas G 1997 *Phys. Rev. Lett.* **79** 1130
- [12] Gloanec M, Rioual S, Lescop B, Zuberek R, Szymczak R, Aleshkevych P, Rouvellou B 2010 *Phys. Rev. B* **82** 144433
- [13] Paul A 2010 *Appl. Phys. Lett.* **97** 032505
- [14] Nolting F, Scholl A, Stöhr J, Seo J W, Fompeyrine J, Siegart H, Locquet J P, Anders S, Lüning J, Fullerton E E, Toney M F, Scheinfein M R, Padmore H A 2000 *Nature* **405** 767
- [15] Ohldag H, Scholl A, Nolting F, Arenholz E, Maat S, Young A T, Carey M, Stöhr J 2003 *Phys. Rev. Lett.* **91** 017203
- [16] Morales R, Li Z P, Olamit J, Liu K, Alameda J M, Schuller I K 2009 *Phys. Rev. Lett.* **102** 097201
- [17] Mishra S K, Radu F, Valencia S, Schmitz D, Schierle E, Dürr H A, Eberhardt W 2010 *Phys. Rev. B* **81** 212404
- [18] Gökemeijer N J, Ambrose T, Chien C L 1997 *Phys. Rev. Lett.* **79** 4270
- [19] Lechevallier L, Zarefy A, Lardé R, Chiron H, Le Breton J M, Baltz V, Rodmacq B, Dieny B 2009 *Phys. Rev. B* **79** 174434
- [20] Ali M, Marrows C H, Hickey B J 2008 *Phys. Rev. B* **77** 134401
- [21] Fu Y Q, Liu Y, Jin C, Yu G H 2009 *Acta Phys. Sin.* **58** 7977 (in Chinese) [付艳强, 刘洋, 金川, 于广华 2009 物理学报 **58** 7977]
- [22] Urazhdin S, Tabor P, Lim W L 2008 *Phys. Rev. B* **78** 052403
- [23] Ma M, Cai L, Wang X F, Hu J G 2007 *Acta Phys. Sin.* **56** 529 (in Chinese) [马梅, 蔡蕾, 王兴福, 胡经国 2007 物理学报 **56** 529]
- [24] Liu Y, Jin C, Fu Y Q, Teng J, Liu M H, Liu Z Y, Yu G H 2008 *J. Phys. D* **41** 205006

# Effect of Pt spacers on interface exchange coupling in ferromagnetic/antiferromagnetic bilayers\*

Wang Yi-Jun Liu Yang Yu Guang-Hua<sup>†</sup>

(School of Materials Physics and Chemistry, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

(Received 13 December 2011; revised manuscript received 7 January 2012)

## Abstract

By inserting a Pt spacer between ferromagnetic (FM)/ antiferromagnetic (FeMn) coupling systems or by doping Pt element in the AFM layer, the depth dependence of Pt spacer and the thickness dependence of Pt doping layer on exchange bias ( $H_{\text{ex}}$ ) and coercivity ( $H_c$ ) are investigated. The results indicate that the number of uncompensated spin moments (UCSs) of NiFe/FeMn( $d_{\text{Pt}}$ )/Pt/FeMn increases as a result of inserting Pt spacer, which enhances  $H_{\text{ex}}$  and  $H_c$  of the system. Also, the distribution depth about 1.3 nm of UCS of FeMn in NiFe/FeMn system is inferred. Besides, by doping Pt element in FeMn near the FM/FeMn interlayer, we find that the  $H_{\text{ex}}$  of the system is enhanced efficiently, which is caused by the huge increase of the number of UCSs in the system.

**Keywords:** magnetic multilayer, exchange coupling, Pt spacer, uncompensated spin moment

**PACS:** 75.70.Ak, 75.70.-i, 81.15.Cd

---

\* Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 51071023, 50831002).

<sup>†</sup> E-mail: ghyu@mater.ustb.edu.cn